

证券代码：688233

证券简称：神工股份

公告编号：2021-044

锦州神工半导体股份有限公司

关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2021年9月15日（周三）10:30-11:30
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”
(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：网络文字互动

一、说明会类型

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021 年半年度报告》，为更好地加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络文字互动的方式召开 2021 年半年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2021 年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间及方式

本次业绩说明会将于 2021 年 9 月 15 日（周三）10:30-11:30 在上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络文字互动的方式召开。

三、参会人员

公司董事长兼总经理潘连胜先生，董事会秘书、财务总监及副总经理袁欣女士，技术研发总监山田宪治先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参与方式

1、投资者可于 2021 年 9 月 15 日 10:30-11:30 登陆上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>), 在线参与本次说明会。

2、投资者可于 2021 年 9 月 13 日 17:00 前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司邮箱 (info@thinkon-cn.com)。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：证券办公室

联系电话：0416-7119889

电子邮箱：info@thinkon-cn.com

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2021 年 9 月 7 日